

碳纤维导热片 Carbon Fibre Thermal Pad

【产品概述 Product Description】

CSF15 复合材料具备密度小、耐久性好等优点。碳纤维是一种各向异性、厚度方向导热性能优异的导热材料。该硅胶片很柔软，很好压缩，用于填充两个物品的界面，使得界面的空气排出，提高导热效率。导热系数 15.0W/m.k。

CSF15 composites have the advantages of low density and good durability. Carbon fiber is an anisotropic and thermally conductive material with excellent thermal conductivity in the thickness direction. The silica gel sheet is very soft and well compressed, and is used to fill the interface of two articles, so that the air of the interface is discharged, and the heat conduction efficiency is improved. Thermal conductivity can reach 15.0W/m.k.

【产品图示 Product illustration】



特性参数 CSF15		
颜色/Color	黑色/Black	目视/Visual
厚度/Thickness	0.50 - 20.0mm	ASTM D374
基材/Metal	液体硅橡胶 Liquid silicone rubber	***
填料/Filler	碳纤维 (C)、 氧化铝 (Al ₂ O ₃)	***
密度/Density	2.8g/cm ³	ASTM D792
导热率/Thermal Conductivity	15.0W/m.K	ASTM D5470
抗电强度/Electrical Strength	0.01KV/mm	ASTM D149
邵氏硬度 (Shore 00)	60~80°	ASTM D2240
伸长率%/Elongation	20%	ASTM D412
拉伸强度/Tensile Strength	15psi	ASTM D412
热阻/Thermal Resistance (1mm, @40psi)	0.11°C*in ² /W	ASTM D5470
适用温度/Operating Temperature(°C)	-50- 160	ASTM D1329
RoHS	PASS	IEC 62321
Halogen	PASS	EN14582
REACH	PASS	EN14372

使用 ASTM D5470 测试工具记录值包括界面热阻。数值仅供参考。实际性能能到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。注：厚度公差：±10%；硬度公差：±5°；颜色/厚度/硬度均可按顾客需求测试。

【特点与优势/Features And Benefits】

- 较高的热导率 High thermal conductivity
- 阻燃性优异 Excellent flame retardant
- 柔韧性好、压缩率高 Good flexibility and high compression ratio

【典型应用/Applications】

- 半导体散热装置 Semiconductor heat sink
- 车载导航仪 Vehicle navigator
- 通讯&电源设备 Communication & power equipment
- 显卡、记忆存储模块 Graphics card, memory module
- LED 照明设备 LED lighting equipment
- LCD 和等离子电视 LCD and plasma TV

【储存&运输】 贮存于通风、阴凉、干燥处，不要接触明火。本产品无毒，按非危险品贮存及运输

【包装】 根据客户需求定制包装

【有效期】 24 个月

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供，但由于我们无法控制产品的使用条件和方法，无法对兼容性的应用提出任何建议，因此这些建议及数据仅供参考，而不作为产品保证。在任何时候，应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前，首先确定我们的材料适用性和建议。

【产品规格 Configurations Available】

According to customer requirements

